



## News Release

### 安靠科技引领 5G 毫米波智能手机、物联网和新兴的天线封装技术应用

美国亚利桑那州坦佩当地时间 2019 年 7 月 22 日，安靠科技（纳斯达克：AMKR），一家领先的半导体封装和测试服务提供商，正在为 5G 毫米波天线封装（AiP）技术做准备。安靠科技的尖端天线封装（AiP）技术已经部署到为智能手机和其他移动设备设计的模块中。从 2018 年 7 月开始，安靠科技是首个进入 5G 毫米波天线封装技术市场的封测厂，在多年的先进系统级封装（SiP）经验的基础上不断扩展。

安靠科技研发副总裁 Ron Huemoeller 表示，“安靠科技已经将我们的天线封装技术部署到一家大型全球通信公司的 5G 产品应用程序中，与他们合作生产首款上市的天线级封装产品。”他补充说：“我们的一个重点是继续开发具有革命性封装概念的天线封装产品，这对实现高度集成电路至关重要。”

据市场研究机构 Yole 预测，预计到 2023 年，射频前端模块系统级封装市场总额将达到 53 亿美元，复合年增长率（CAGR）为 11.3%。

Yole 韩国首席分析师兼包装、封装&基板业务总监 Santosh Kumar 说：“5G 将为封装和测试服务供应商带来更多的封装业务。智能手机中典型的射频前端组件包括各种开关、滤波器、放大器和天线本身，为了在越来越小的表面上开发电路，实现越来越多的频带，对系统级封装技术的需求将不断增加。”

除了强大的系统级封装产能和天线封装技术外，安靠科技还开发了一套广泛的工具集，以最大限度地提高电路密度，并解决生产 5G 应用所需的复杂封装形式，如双面封装、晶片埋入式基板、先进的 RDL Molding 以及各种类型的射频屏蔽。该工具集与我们在射频和天线封装设计方面的专业知识相结合，使得安靠科技成为那些希望将高投入技术挑战性的 5G 多芯片先进封测技术外包的客户的独家供应商。

随着支持 5G 的封装产品需求开始攀升，安靠科技已经在顺利实施天线封装技术。如果要进一步了解安靠科技在系统级封装和天线封装的能力，请访问 <https://amkor.com/aip-aop/>

关于安靠科技：

安靠科技是全球最大的半导体封装和测试的外包服务提供商之一。安靠科技成立于 1968 年，作为一直致力于半导体集成电路封装和测试外包的先驱者，目前是 250 多家世界领先的半导体设计公司、晶圆厂和电子设备制造商的战略制造合作伙伴。安靠的运营基地占地面积 1100 万平方英尺，包括工厂、产品开发中心以及销售办公室，其位于亚洲、欧洲和美国主要电子制造区域。更多信息请关注网站：[www.amkor.com](http://www.amkor.com)。

###



## News Release

### **Keywords**

OSAT

Semiconductor packaging

Advanced IC packaging

Assembly and test

Antenna-in-package

System-in-package

SiP

AiP

5G mmWave

RDL molding

RF shielding

IoT

Smartphone

### **Contacts**

#### Investor Relations

Vincent Keenan

Vice President, Investor Relations

480-786-7594

#### Media Relations

Debi Polo

Senior Manager, Marketing Communications

480-786-7653

**Social Media:** @amkortechology